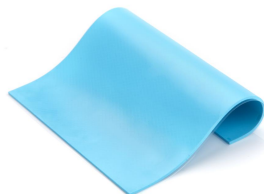


H500-LY 常规系列

【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

应用特点：

- 柔软，低出油，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐温性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度：≤30℃

储存湿度：≤70%

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：2年

不符合储存条件下：6个月

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	丹青色	---	目视
厚度	1~3	mm	ASTM D 374
硬度	40~55(±5)	Shore C	ASTM D 2240
密度	3.2(±0.5)	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥0.1	Mpa	ASTM D 412
延伸率	≥60	%	ASTM D 412
出油率	≤0.8	%	--
油径比	≤103	%	--
压缩比	≥15 (@50psi)	%	ASTM D 695
阻燃等级	V-0	---	UL-94
使用温度	-50~150	℃	IEC 60068-2-14
短期耐高温	250	℃	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	5.0(±0.5)	W/m•K	ASTM D 5470
热阻	≤0.7 (@20Psi/1mm)	°Cin ² /W	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥8	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 ¹⁰	Ω•cm	ASTM D 257
介电常数	≥5	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权